

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年6月23日 (23.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

WO 2005/056683 A1

(51) 国際特許分類: C08L 101/00, C08K 3/00,
C08L 63/00, C08K 3/34, H05K 1/03

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/018614

(22) 国際出願日: 2004年12月14日 (14.12.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-417176
2003年12月15日 (15.12.2003) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.)
[JP/JP]: 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満 2丁目4番4号 Osaka (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柴山 晃一 (SHIBAYAMA, Koichi) [JP/JP]: 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山 2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP) 米澤 光治 (YONEZAWA, Koji) [JP/JP]: 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山 2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 宮▼崎▲主税, 外 (MIYAZAKI, Chikara et al.), 〒5-100012 大阪府大阪市中央区谷町 1丁目6番5号 西村ビル Osaka (JP)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

一 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受理の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THERMOSETTING RESIN COMPOSITION, MATERIAL FOR SUBSTRATE AND FILM FOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 熱硬化性樹脂組成物、基板用材料及び基板用フィルム

(57) Abstract: Disclosed is a thermosetting resin composition which enables to obtain a molded article that is excellent in mechanical properties, dimensional stability and heat resistance and is further capable of maintaining the shape of the article molded before curing even after the resin composition is cured. The thermosetting resin composition contains 100 parts by weight of a thermosetting resin and 1-100 parts by weight of an inorganic compound dispersed in the thermosetting resin, and the dispersion particle diameter of the inorganic compound is not more than 2 μ m. Not less than 75% of the shape of an article molded before curing is maintained after the resin composition is cured. Also disclosed are a material for substrates and a film for substrates respectively composed by using such a thermosetting resin composition.(57) 要約: 力学的物性、寸法安定性及び耐熱性に優れている成形品を提供し得るだけでなく、硬化前に成型された形状を硬化後も良好に保持し得る熱硬化性樹脂組成物を提供する。熱硬化性樹脂100重量部と、前記熱硬化性樹脂中に分散された無機化合物1~100重量部とを含み、前記無機化合物の分散粒径が2 μ m以下であり、硬化前に成型した形状が、硬化後に75%以上保持されている熱硬化性樹脂組成物、並びに該熱硬化性樹脂組成物を用いて構成されている基板用材料及び基板用フィルム。

WO 2005/056683 A1